

台北市電腦商業同業公會 函

地址：105 台北市松山區八德路三段 2 號 3 樓

聯絡人：李宛庭

電話：(02) 2577-4249 分機 973

傳真：(02) 2579-1383

112

臺北市北投區文林北路77號

受文者：臺北市立中正高級中學

發文日期：中華民國113年9月12日

發文字號：電會字第1130008620號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：活動宣傳海報乙張

主旨：檢送國科會「2024 台灣創新技術博覽會-未來科技館」活動海報，惠請貴校張貼活動資訊，並鼓勵貴校師生踴躍參與，請查照並轉知。

說明：

一、台灣創新技術博覽會由 11 大部會共同主辦，其中由國科會、中研院、教育部、衛福部統籌的未來科技館，以「全球科研鏈結台灣」為主題，展覽中聚焦半導體、淨零科技、精準健康、AI 智慧應用、電子光電、新穎化工材料及人文科技等領域，同時展出 2024 未來科技獎獲獎技術。

活動網站：www.futuretech.org.tw

二、展覽除同時匯聚百件的創新科技外，更有 AI 智慧、健康台灣等主題專區融合科普手法帶領學子了解產業趨勢激發科學熱情。為使各界深入了解與體驗展出技術，主辦單位於展期間提供 5 人以上團體預約參觀服務，即日起受理預約至 113 年 10 月 15 日下午五點止，預約網址：https://pse.is/FUTEX_D11p00058

三、為宣傳活動資訊，敬祈張貼活動海報，俾使貴校師生知悉活動訊息，共襄盛舉。展覽聯繫窗口：台北市電腦公會李

1136011011

113. 9. 16

宛庭小姐，服務電話：(02)2577-4249 分機 973 ；電子郵件
信箱：wanting@mail.tca.org.tw。

四、隨函檢附本活動宣傳海報，惠請協助張貼。

正本：各大專院校、各高中職
副本：

台北市電腦商業同業公會

裝

訂

線